



## Halbleiterwerk Reutlingen

25. Mai 2021

PI 11317 BBM Fi/af

- ▶ Fertigungsanlagen  
150-Millimeter-Technologie seit 1995  
200-Millimeter-Technologie seit 2010  
Testzentrum für Halbleiter  
Im Halbleiterwerk in Reutlingen werden seit 1970 Halbleiter (Integrierte Schaltungen) gefertigt.
  
- ▶ Reinraumfläche  
35 000 m<sup>2</sup>,  
weitere 1 000 m<sup>2</sup> ab Herbst 2021
  
- ▶ Mitarbeiter  
3 500
  
- ▶ Fertigungstechnologie  
150- und 200-mm-Siliziumsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 180 nm; 1 nm ist ein Millionstel Millimeter  
  
150-mm-Siliziumkarbidsubstrate (Wafer) mit Strukturbreiten bis 400 nm
  
- ▶ Gefertigte Produkte  
Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), mikroelektromechanische Systeme (MEMS), Leistungshalbleiter
  
- ▶ Einsatzgebiete der Halbleiter  
Automobilelektronik: Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP, elektronische Steuerungen für Verbrennungs- und Elektromotoren sowie Getriebe, Airbag- und Fahrerassistenzsysteme, Einparkhilfe, Nachtsichtsysteme  
  
Konsumentenelektronik: Smartphones, Laptops, Wearables, Hearables, Spielekonsolen, Drohnen